

强于大市

半导体行业周报

Entegris 拟收购抛光材料龙头 CMC Materials, 概伦电子 IPO 发行价 PS 为 60 多倍

市场对半导体需求仍处于较高水平,下游芯片商涨价动作不断。尽管目前晶圆厂、IDM 等产能建设加快进度,但由于零部件和芯片组件的短缺,使得半导体设备收入确认慢于订单增长,设备端仍有大量在手订单等待交付。

行业动态:

- **IPO 进度:** 概伦电子发行市值 123 亿元, PS 为 60 多倍; 炬光科技已于 12 月 15 日发行, 发行价 78.69 元/股; 【苏州】国芯科技将于 12 月 24 日发行。截至 2021/12/19, 共有 129 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等, 概伦电子发行定价 28.28 元/股, 对应 PS 60 多倍; 炬光科技已于 12 月 15 日发行, 发行定价 78.69 元/股; 【苏州】国芯科技将于 12 月 24 日发行; 龙芯中科、江波龙已过会; 广立微待上会; 中微股份(深圳)回复二轮问询; 歌尔微电子已完成上市辅导。
- **功率半导体:** 新型功率半导体器件开发商芯长征完成超 5 亿元 C 轮融资, 碳化硅功率器件厂商森国科完成 C 轮亿元级融资。12 月 16 日, 新型功率半导体器件开发商芯长征宣布完成超 5 亿元 C 轮融资, 本轮融资由鼎晖投资领投, 北汽产业投资、高榕资本、芯动能投资、华登国际等跟投。该笔资金将主要用于进一步加强新能源汽车和光伏类产品研发投入, 并持续扩大产能。12 月 14 日, 国内领先的碳化硅功率器件厂商森国科宣布完成 C 轮亿元融资。本轮投资领投方为中金资本, 国家科学技术部下属国家科技风险开发事业中心投资的中科海创基金、凌霄泵业(002884.SZ)跟投。本轮融资将继续用于产研投入、业务拓展和服务体系的升级, 推动产品研发及迭代。
- **半导体材料:** 美国半导体材料供应商 Entegris 将收购全球 CMP 抛光材料龙头 CMC Materials, 交易总价值为 65 亿美元; 德国默克宣布在台湾投资 38.96 亿元加码半导体材料研发。当地时间 12 月 15 日, 美国半导体材料厂商 Entegris 宣布, 将收购竞争对手 CMC Materials, 交易总价值为 65 亿美元, 交易预计将于 2022 年下半年完成。这将丰富 Entegris 的事业组合, 从而在半导体材料领域更接近成为一站式供应商。半导体材料供应商德国默克 14 日宣布, 将在 5-7 年内投资台湾约新台币 170 亿元(约合人民币 38.96 亿元), 专注电子科技事业体系新产线及研发实力的大幅扩张, 并着重半导体事业发展。
- **半导体设备:** 2021 年全球半导体设备销售额将首破 1000 亿美元, 中国大陆成最大市场。12 月 14 日, 国际半导体产业协会(SEMI)发布年终整体全球原始设备制造商(OEM)半导体设备预测报告, 2021 年全球半导体制造设备总销售额将首次突破 1000 亿美元大关, 达到 1030 亿美元, 较 2020 年的 710 亿美元飙升 44.7%, 同时预计 2022 年将进一步增长至 1140 亿美元。12 月 12 日晚, 半导体设备厂商晶盛机电公告称, 绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组于 12 月 9 日下发了《关于在全区范围内全面加强管控措施的公告》, 要求全区范围内“除防疫需要、民生保障外, 其他企业一律停工”。根据上述通告, 公司及下属公司位于上虞的厂区开始有序停产, 全力配合政府防疫工作, 遏制疫情扩散和蔓延。
- **晶圆代工/芯片制造:** SK 海力士加码无锡, 全力进攻中国 8 吋晶圆代工市场; 宝马宣布与德国芯片制造商 IIINOVA、美国芯片制造商 Global Foundries 结盟。据台媒 MoneyDJ 报道, SK 海力士(SK Hynix)冲刺晶圆代工事业, 出手进攻中国市场。旗下关系企业 SK Hynix System IC 即将关闭南韩 M8 厂, 设备转运往中国无锡。SK Hynix System IC 无锡厂 2020 年第一季完工, 2020 年下半年开始搬运 M8 厂设备至无锡, 新厂已部分营运。SK Hynix System IC 预计明年上半年完成迁厂事宜, 届时将全力进攻中国 8 吋晶圆代工市场。《科创板日报》英特尔 CEO 基辛格昨日与台积电高层见面, 获得 3nm 代工产能。12 月 8 日, 宝马表示公司与德国芯片制造商 IIINOVA、美国芯片制造商 Global Foundries 签订了一项长期芯片供应协议, 以保证每年“几百万”枚芯片的供应。
- **IC 设计:** 苹果自研射频芯片, 高通(Qualcomm)第三季总营收攀升至 77 亿美元, 位居全球设计企业第一。12 月 16 日, 据财联社报导, 消息称苹果正在加利福尼亚州尔湾设立新办公室, 同时开始招募工程师, 寻找拥有射频芯片、RFIC(射频集成电路)和无线 SoC 研发经验的人才, 苹果还将研发蓝牙和 Wi-Fi 芯片。据 TrendForce 数据, 得益于今年火热的半导体市场, 2021 年第三季度全球前十大 IC 设计业者总计营收达 337 亿美元, 同比增长 45%。其中, 高通第三季总营收攀升至 77 亿美元, 同比增长 56%, 位居全球第一。

投资建议:

- **设备组合:** 盛美上海、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份; 建议关注: 晶盛机电、光力科技、神工股份
- **材料组合:** 沪硅产业、雅克科技、安集科技、晶瑞电材; 建议关注: 立昂微、彤程新材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体:** 新洁能、华润微; 建议关注: 斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注:** 圣邦股份、思瑞浦
- **射频建议关注:** 卓胜微
- **FPGA 建议关注:** 安路科技
- **CIS:** 韦尔股份、建议关注: 格科微
- **MCU:** 兆易创新; 建议关注中颖电子
- **其他建议关注:** 三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

- 疫情影响超预期; 半导体设备国产化进程放缓; 半导体材料国内市场增速放缓; 美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

相关研究报告

《半导体行业周报: 先进制程竞争加速, 国产半导体材料积极推进》20211213

《半导体行业周报: 三季度全球半导体设备出货金额续创新高, 芯导科技上市》20211206

《化工行业 2022 年策略: 优秀龙头有望价值重估, 新材料发展空间广阔》20211206

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

半导体

证券分析师: 杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号: S1300514080001

证券分析师: 余嫻嫻

(8621)20328550

yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号: S1300517050002

目录

拟 IPO 的半导体企业汇总	4
半导体设备国产化情况	8
行业数据回顾	9
上周信息汇总	13
IC 设计	13
半导体设备	13
半导体材料	13
晶圆代工&芯片制造	14
功率器件	16
风险提示	17

图表目录

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/12/19）	4
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/12/19）	5
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/12/19）	6
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/12/19）	7
图表 2. 半导体拟 IPO 统计-按类别划分	7
图表 3. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化最新情况及主要国内厂家	8
图表 4. 全球半导体销售额当月值	9
图表 5. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比	9
图表 6. 日本半导体设备制造商出货额与同比	10
图表 7. 美国与国内半导体指数对比	10
图表 8. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比	10
图表 9. 美国与国内半导体指数对比（周度环比）	11
图表 10. DRAM 与 NAND Flash 现货均价对比（周度环比）	11
图表 11. 申万半导体材料指数	11
图表 12. 全球半导体级硅片出货量预测	12
图表 13. 半导体器件封装材料进出口金额	12
图表 14. 半导体器件封装材料进出口单价	12
图表 15. 上周半导体相关个股周度涨跌幅	12

拟 IPO 的半导体企业汇总

截至 2021/12/19，共有 129 家半导体企业申报 IPO，上周共有 8 家拟上市企业状态发生变更。

- **已定价：**炬光科技（高功率半导体激光器及微光学相关产品，发行定价 78.69 元/股）；概伦电子（EDA，发行定价 28.28 元/股，对应市值 123 亿元）
- **公布发行日期：**【苏州】国芯科技（嵌入式 CPU 开发，12.24 发行）
- **过会：**龙芯中科（CPU 指令系统）；江波龙（Flash、DRAM 存储器）
- **待上会：**广立微（集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备）
- **问询：**中微股份（深圳）（数模混合信号芯片、模拟芯片）
- **完成上市辅导：**歌尔微电子（MEMS 芯片、ASIC 芯片、智能语音处理芯片）

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截至 2021/12/19）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	概伦电子	已发行 定价 28.28 元/股	招商证券	2010	软件	EDA 软件
2	炬光科技	已发行 定价 78.69 元/股	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品
3	创耀科技	已注册	海通证券	2006	设计	通信芯片
4	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
5	屹唐股份	提交注册	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
6	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
7	【苏州】国芯科技	12.24 发行	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
8	云天励飞	提交注册	中信证券	2014	设计	AI 芯片
9	必易微	提交注册	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
10	长光华芯	提交注册	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
11	天岳先进	提交注册	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
12	拓荆科技	提交注册	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
13	希荻微	提交注册	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
14	臻镭科技	提交注册	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
15	唯捷创芯	提交注册	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
16	东微半导体	提交注册	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
17	华大九天	提交注册	中信证券	2009	软件	EDA 软件
18	纳芯微	提交注册	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
19	英集芯科技	提交注册	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
20	晶导微	提交注册	中信证券	2013	分立器件	二极管、整流桥等分立器件、集成电路系统级封装(SiP)
21	华卓精科	过会	东兴证券	2012	零部件	超精密测控装备部件及整机，首家光刻机双工件台厂商
22	思特威	过会	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
23	莱特光电	过会	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
24	峰岷科技	过会	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
25	好达电子	过会	安信证券	1999	设计	SAW Filter
26	赛微微	过会	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片
27	思科瑞	过会	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
28	龙芯中科	过会	中信证券	2010	设计	CPU
29	江波龙	过会	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
30	芯龙半导体	问询	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
31	麦斯克	问询	国泰君安	1995	材料	硅片

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/12/19)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
32	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
33	龙腾半导体	问询	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
34	富乐德	问询	光大证券	2017	维保	泛半导体 (半导体、显示面板等) 领域设备精密洗净、维修等服务
35	天德钰	问询	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
36	奥比中光	问询	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
37	烁映微	问询	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
38	广立微	待上会	中金公司	2003	软件	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
39	中科蓝讯	问询	中金公司	2016	设计	无线音频 SoC 芯片
40	国微思尔芯	问询	中金公司	2003	软件	EDA
41	联动科技	问询	海通证券	1998	设备	半导体自动化测试系统
42	安芯电子	问询	国元证券	2012	设计	FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片
43	杰理科技	问询	中信建投	2014	设计	射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片 (SOC)
44	国博电子	问询	招商证券	2010	设计	有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频
45	德邦科技	问询	东方证券	2003	材料	半导体封装、粘合、散热等功能性材料
46	恒烁股份	问询	国元证券	2015	设计	NOR Flash 存储芯片和 MCU 芯片研发
47	晶华微	问询	海通证券	2005	设计	HART 调制解调器芯片、4~20mA 电流 DAC 芯片
48	比亚迪半导体	问询	中金公司	2004	设计	功率半导体
49	新汇成	问询	海通证券	2011	封测	显示驱动芯片封测, 驱动 IC 的金凸块、测试、切割和封装 (COG/COF) 服务
50	海光信息	问询	中信证券	2014	设计	CPU
51	中微股份(深圳)	问询	中信证券	2001	设计	数模混合信号芯片、模拟芯片
52	中图科技	中止 (财报更新)	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
53	路维光电	中止 (财报更新)	国信证券	2012	材料	掩模板
54	晶合集成	中止 (财报更新)	中金公司	2015	代工	12 英寸晶圆代工, DDIC
55	铖昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
56	德明利	已申报	东莞证券	2008	设计	闪存主控芯片
57	华微科技	已申报	华泰联合	2003	设计	MCU、FPGA、电源管理芯片
58	帝奥微电子	已申报	中信建投	2010	设计	混合信号产品线、电源管理、ACDC 高压大功率产品、模拟集成电路设计
59	耐科装备	已申报	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
60	振华风光	已申报	中信证券	2005	IDM	高可靠半导体模拟集成电路
61	蓝箭电子	已申报	金元证券	1998	分立器件	三极管、二极管和场效应管, 同时对外承接半导体封装测试
62	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
63	艾森半导体	完成上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
64	江苏影速	完成上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
65	中科飞测	完成上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
66	歌尔微电子	完成上市辅导	中信建投	2017	设计	MEMS 芯片、ASIC 芯片、智能语音处理芯片
67	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
68	和美精艺	上市辅导	开源证券	2007	材料	封装基板
69	金誉半导体	上市辅导	浙商证券	2011	设计	电源管理芯片、低中高压 MOS 管、单片机和功率器件
70	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
71	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
72	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
73	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
74	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管
75	富创精密	已申报	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/12/19)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
76	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
77	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
78	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
79	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
80	南麟电子	上市辅导 (由科创板转为北交所)	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
81	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
82	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	一站式定制芯片及 IP 供应商
83	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
84	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
85	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
86	兰宝传感	上市辅导	海通证券	1998	设计	传感器
87	敏芯半导体	上市辅导	中金公司	2017	设计	光通信用激光器和探测器芯片
88	泰凌微	上市辅导	安信证券	2010	设计	高性能低功耗无线物联网 SOC
89	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
90	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
91	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料
92	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
93	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
94	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
95	芯愿景	上市辅导	民生证券	2002	设计	IC 技术分析、IC 设计服务
96	越亚半导体	上市辅导	方正证券	2006	材料	封装基板
97	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
98	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权
99	新恒汇电子	上市辅导	平安证券	2017	材料	晶圆测试减划、封装材料高精度蚀刻金属引线框架、物联网 eSIM 封装
100	映日科技	上市辅导	安信证券	2015	材料	靶材
101	绍兴中芯	上市辅导	海通证券	2018	代工	专注于功率、传感和传输应用, 特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工服务的制造商
102	有研半导体	上市辅导	中信证券	2001	材料	硅片
103	京仪装备	上市辅导	国泰君安	2016	设备	半导体温控装置系列 (Chiller)
104	盛科通信	上市辅导	中金公司	2019	设计	以太网交换芯片
105	思必驰	上市辅导	中信证券	2007	设计	AI 芯片
106	欣盛半导体	上市辅导	中信建投	2016	IDM	COF 封装显示驱动芯片
107	立功科技	上市辅导	国信证券	1999	分销	代理分销
108	兴福电子	上市辅导		2008	材料	电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品
109	燕东微	上市辅导	中信建投	1987	IDM	功率半导体、声光电传感器、声光电 ASIC、精密器件
110	微导纳米	上市辅导	浙江证券	2015	设备	ALD 和 RIE
111	新相微	上市辅导	中金公司	2005	设计	LCD 驱动芯片、CMOS SENSOR
112	慧智微	上市辅导	华泰联合	2011	设计	高性能微波射频前端芯片
113	灿瑞科技	上市辅导	中信证券	2005	设计	光电驱动芯片、磁传感器、光学传感器
114	海光芯创	上市辅导	华泰联合	2011	设计	光电子芯片和光电子器件
115	忆恒创源	上市辅导	中金公司	2011	设计	企业级 NVMe SSD 产品
116	芯思杰	上市辅导	中信证券	2015	设计	光芯片设计、制造、封测
117	汇泰科技	上市辅导	长江证券	2007	设计	光电成像、触控、MCU 等芯片
118	炬泉光电	上市辅导	国金证券	2005	设计	计量芯片、MCU 和电力载波芯片
119	星宸科技	上市辅导		2017	设计	视频监控芯片
120	中感微	上市辅导	国金证券	2009	设计	音频传感网主芯片、视频传感网芯片、电池电源管理芯片
121	腾盛精密	上市辅导	国金证券	2006	设备	封测设备
122	佰维储存	上市辅导	中信证券	2010	封测	智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组和以 SiP 为核心的先进封测服务
123	润玛电子	上市辅导	海通证券	2002	材料	微电子制造用超净高纯电子化学品
124	招金励福	上市辅导	民生证券	2002	材料	封装材料

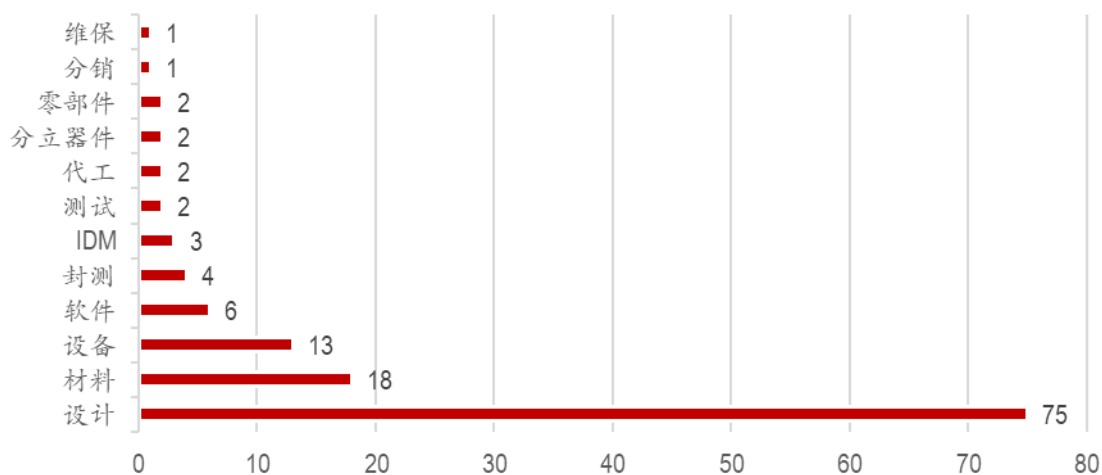
资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截至 2021/12/19)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
125	龙迅半导体	上市辅导	中金公司	2006	设计	高清视频信号处理芯片、高速信号传输芯片
126	钰泰半导体	上市辅导	海通证券	2008	设计	DC/DC 电源管理 IC
127	东科半导体	上市辅导	海通证券	2009	设计	高频高效绿色电源 IC 和大功率电源 IC
128	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
129	华岭股份	(北交所)	中信建投	2001	封测	集成电路测试

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

图表 2. 半导体拟 IPO 统计-按类别划分



资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

半导体设备国产化情况

据国内主流 12 英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在 12 类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为 83.7%，CVD、PVD、刻蚀、热处理等设备的国产化率积极提升。

图表 3. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化最新情况及主要国内厂家

	2021/9 (%)	2021/10 (%)	2021/11 (%)	较上周国产化率变动	主要国内厂家
CMP	29.4	28.7	28.7	无变化	华海清科
CVD	3.3	3.8	3.9	无变化	沈阳拓荆、盛美半导体、北方华创
PVD	17.9	17.3	20.0	无变化	北方华创
刻蚀	23.4	23.3	23.6	无变化	中微公司、北方华创、屹唐半导体
清洗	24.7	24.7	24.7	无变化	盛美半导体、北方华创、芯源微
去胶	83.7	83.7	83.7	无变化	屹唐半导体
热处理	25.3	25.4	26.3	无变化	北方华创、屹唐半导体、盛美半导体
离子注入	1.4	1.4	1.4	无变化	中科信、万业企业
量测	2.3	2.3	2.3	无变化	上海精测、中科飞测、上海睿励、东方晶源
光刻	1.2	1.2	1.2	无变化	上海微电子
涂胶显影	1.1	1.1	1.1	无变化	芯源微

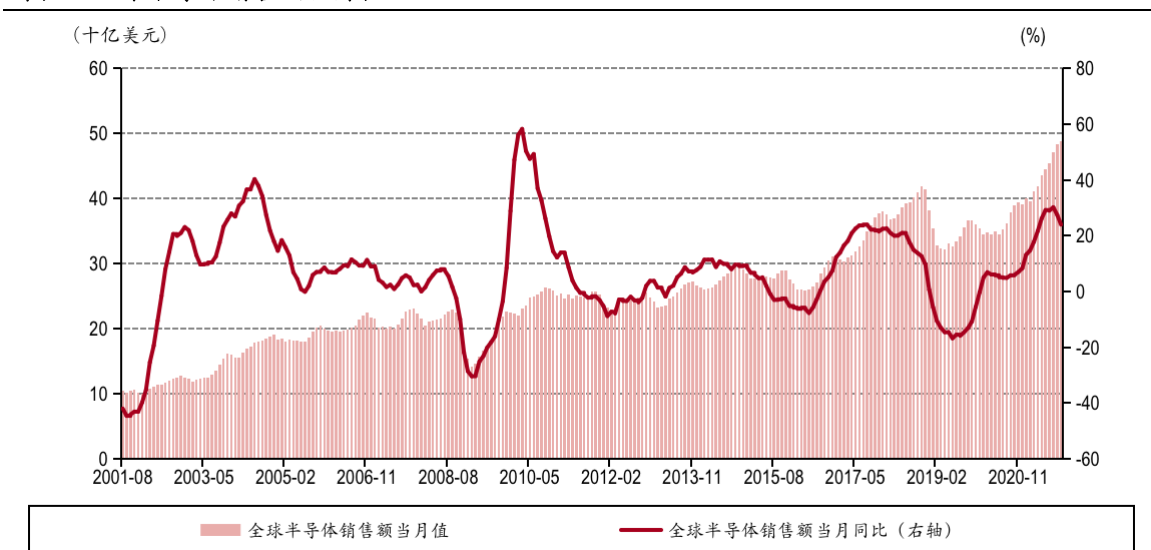
资料来源：中国国际招标网，中银证券

行业数据回顾

10月全球半导体销售额达487.9亿美元，同比增速继续回落。据美国半导体产业协会SIA数据，10月全球半导体销售额较9月482.8亿美元增长1.06%，同比增速从9月的27.6%收窄至24.0%，仍保持较高增速。10月半导体销售额欧洲市场增幅达27.3%，美洲市场增幅达29.2%，亚太地区/所有其他地区市场增幅达29.2%。

根据SIA预计，今年全球半导体的销售额将达到5530亿美元，将创下历史新高，同比增长25.6%。明年，全球半导体的销售额仍将保持增长，但增速会放缓，预计同比增长8.8%，销售额将达6015亿美元。

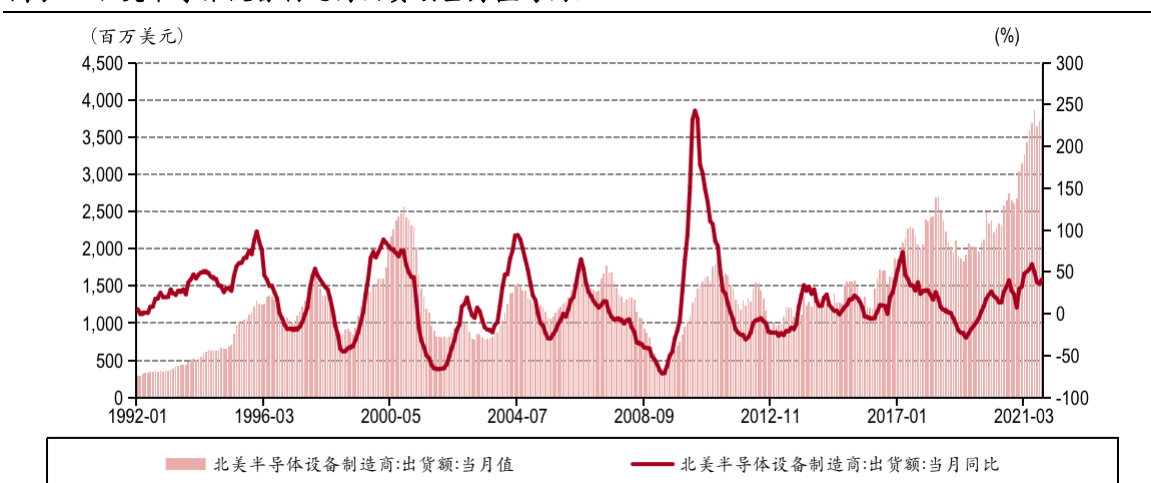
图表4. 全球半导体销售额当月值



资料来源：万得，美国半导体产业协会，中银证券

10月北美半导体设备出货金额37.4亿美元，环比小幅上涨。据SEMI统计，10月北美半导体设备出货金额为37.4亿美元，较9月的37.2亿美元上升0.6%，较2020年同期26.5亿美元上升41.3%。2021年1-10月份出货额的环比增幅分别为13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%、4.5%、-5.4%、1.9%、0.6%。

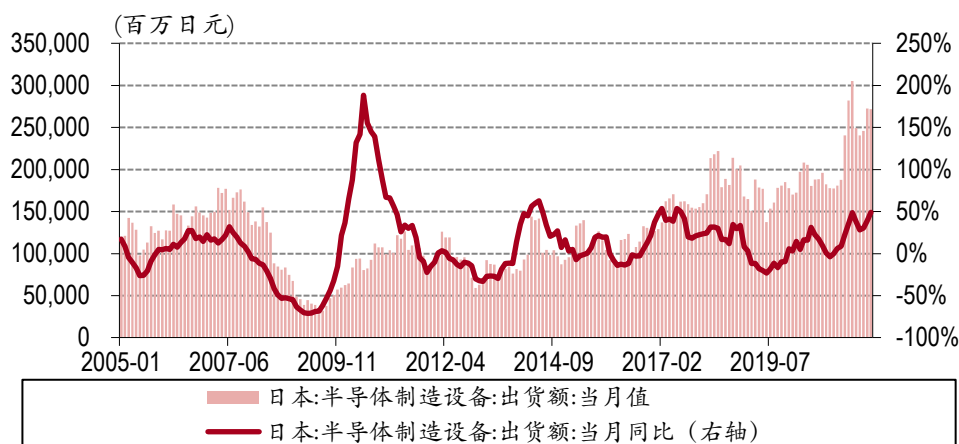
图表5. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比



资料来源：万得，SEMI，中银证券

10月日本半导体设备出货金额2719亿日元，较上月有所回落。据日本半导体制造装置协会统计，10月日本半导体设备出货金额小幅下跌，较9月的2724亿日元下跌0.17%，相比于2020年同期1824亿日元上升49.1%。2021年1-10月份出货额的环比增幅分别为1.9%、3.7%、28.4%、17.2%、8.3%、-18.3%、-3.5%、2.1%、10.9%、-0.17%。

图表 6. 日本半导体设备制造商出货额与同比



资料来源：万得，日本半导体制造装置协会，中银证券

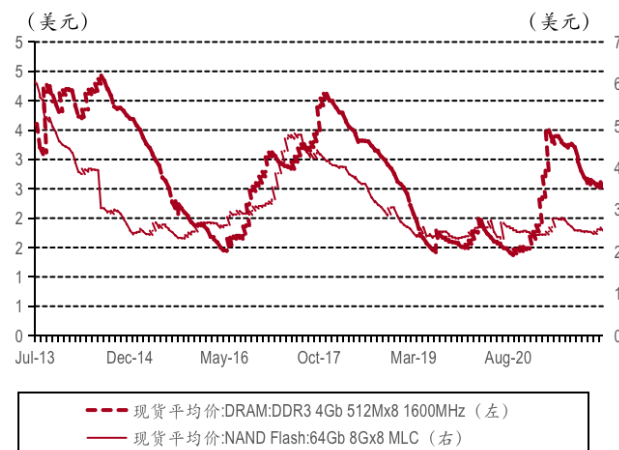
半导体指数下跌，存储价格回升。近一周申万行业半导体指数报6368.06，周度环比下跌4.62%，指数与前期稳定上升趋势相比显现出小幅震荡；费城半导体指数收报3761.04点，周度环比下跌3.92%。近一周存储现货均价回升，NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 周度环比上涨2.9%，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 价格较上周上涨2.8%。

图表 7. 美国与国内半导体指数对比



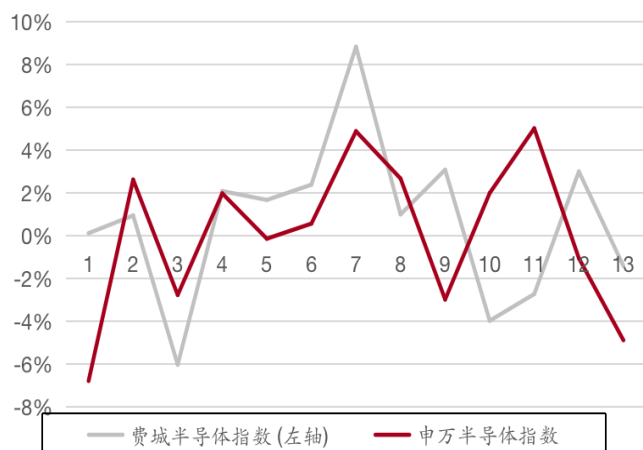
资料来源：万得，中银证券

图表 8. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比



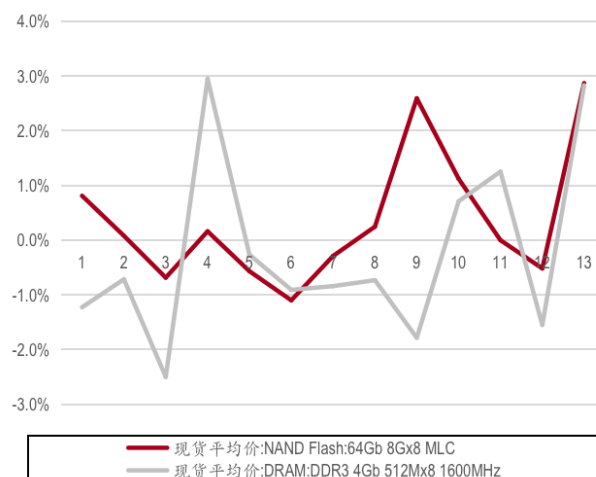
资料来源：万得，中银证券

图表 9. 美国与国内半导体指数对比（周度环比）



资料来源：万得，中银证券

图表 10. DRAM 与 NAND Flash 现货均价对比（周度环比）



资料来源：万得，中银证券

本周申万半导体材料指数收报 9906.79 点，较上周收盘下跌 0.38%。半导体材料指数跌幅环比略有收窄，高位震荡的趋势未改变。

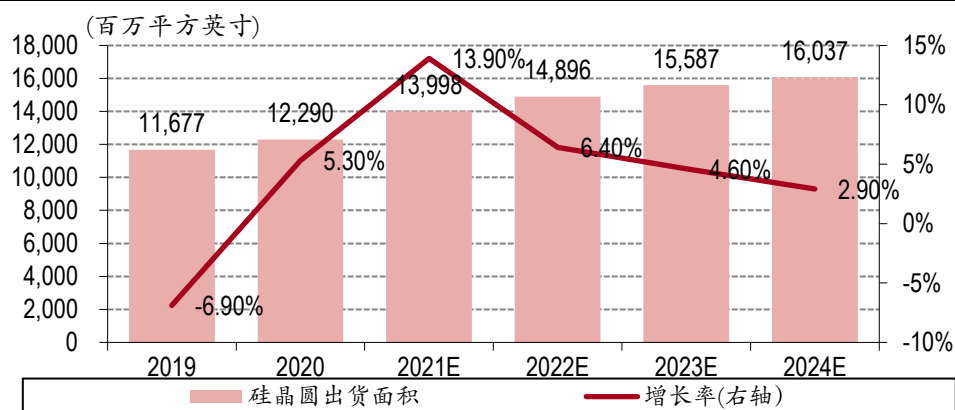
图表 11. 申万半导体材料指数



资料来源：万得，中银证券

硅晶圆：环球晶圆（GlobalWafers）表示目前在手订单金额达新台币 1000 亿元，尽管尽了最大的努力提高生产效率，仍无法在 2024 年之前满足客户所有订单，将力求改善良率及生产效率，扩充 12 英寸硅晶圆的产能。

图表 12. 全球半导体级硅片出货量预测



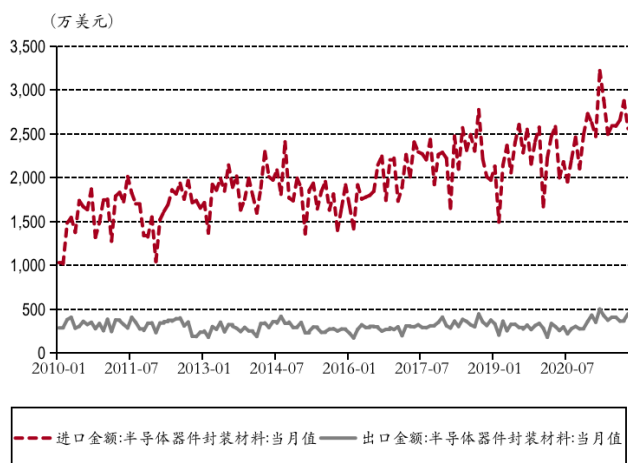
资料来源: SEMI, 中银证券

光刻胶: 12月17日, 上海新阳披露与 Heraeus 签署了《合作备忘录》, 双方计划共同开发半导体行业用光刻胶产品及相关材料; 合作期限自双方签署之日起 3 年。公司签署该协议旨在完善光刻胶供应链, 为光刻胶项目的开展提供材料和技术保障。

电子特气: 12月13日, 和远气体披露关于电子特气产业园项目联合试车成功的公告, 公司位于湖北潜江经济开发区的电子特气产业园项目本年已完成工程主体建设及设备安装、调试工作, 试生产方案已经专家评审通过。近日, 项目经联合试生产, 已产出部分产品, 项目联合试车成功。

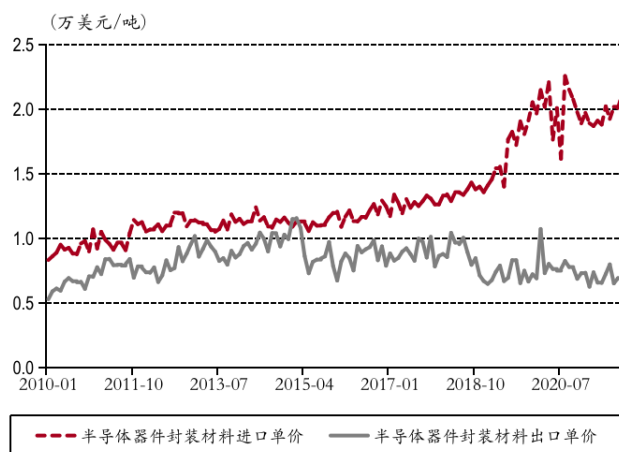
封装材料: 康强电子 12月3日在深交所互动易上表示, 公司生产的半导体封装材料为引线框架和键合丝, 不包括 ABF 载板。

图表 13. 半导体器件封装材料进出口金额



资料来源: 万得, 海关总署, 中银证券

图表 14. 半导体器件封装材料进出口单价



资料来源: 万得, 海关总署, 中银证券

图表 15. 上周半导体相关个股周度涨跌幅

代码	简称	周度跌幅 (%)	代码	简称	周度涨幅 (%)
300077.SZ	国民技术	(12.50)	300831.SZ	派瑞股份	15.74
300223.SZ	北京君正	(10.34)	688589.SH	力合微	14.40
600460.SH	士兰微	(9.79)	688608.SH	恒玄科技	9.40
300373.SZ	扬杰科技	(9.74)	688008.SH	澜起科技	8.00
688396.SH	华润微	(9.21)	002409.SZ	雅克科技	7.07

资料来源: 万得, 中银证券

上周信息汇总

IC 设计

【行业】多家汽车公司涉足 IC 设计

全世界集成 IC 荒重挫汽车工业，促进标致汽车、通用汽车公司准备跨足半导体材料业务流程，福特汽车周四（18 日）与晶圆代工大型厂格罗方德达到战略协议，合作开发、生产制造集成 IC，并在国外协同生产制造车配集成 IC。通用汽车公司也跟高通芯片、恩智浦半导体材料等企业达成共识，合作开发和生产制造集成 IC。标致汽车更进一步，公布将设计制作集成 IC，改进新能源汽车自驾游作用及充电电池系统软件，对于跟格罗方德签订是为了更好地加强最近集成 IC 供货，由于相比于别的汽车企业，标致汽车受集成 IC 紧缺、总产量降低的状况更为比较严重。此外，福特汽车、福斯、通用性和其它关键汽车企业正与充电电池企业合作，修建新加工厂，保证技术性优点和将来供货平稳。

（资料来源：皮卡世界）

【行业】2021 年第三季 IC 设计公司营收排名出炉：高通位居榜首

12 月 16 日，CNMO 从 TrendForce 集邦咨询了解到，得益于今年火热的半导体市场，2021 年第三季全球前十大 IC 设计业者总计营收达 337 亿美元（约合人民币 2145 亿元），年增 45%。具体来看，在 5G 手机以及消费电子、边缘网络与工业领域的需求带动下，高通（Qualcomm）第三季总营收攀升至 77 亿美元，年增 56%，位居全球第一。紧随其后的是英伟达（NVIDIA），公司第三季度营收为 66 亿美元，年增 55%。

（资料来源：CNMO 新闻）

【英唐智控】签署《英唐半导体产业园项目之合作协议》

公告称深圳市英唐智能控制股份有限公司与中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司签署了《中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司关于英唐半导体产业园项目之合作协议》，三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目围绕半导体产业，从传感器、功率半导体、电源管理芯片等产品类型入手，规划从 IC 设计、特色 FOUNDRY 产线、封装、测试、以及方案开发及应用等各环节产业，形成半导体全产业链产业园区。

（资料来源：英唐智控公告）

【行业】传苹果将自研射频芯片 高通博通恐出局

16 日有消息称苹果正在加利福尼亚州尔湾设立新办公室，同时开始招募工程师，寻找拥有射频芯片、RFIC（射频集成电路）和无线 SoC 研发经验的人才，苹果还将研发蓝牙和 Wi-Fi 芯片。苹果的这些芯片目前由博通、Skyworks、高通提供。目前，苹果自制芯片除了核心的处理器之外，还扩及到电源管理芯片、显示屏驱动芯片、GPU、基频芯片、指纹辨识芯片、3D 体感芯片等，其多款产品早已用上了自家芯片。最新消息显示，苹果自研的基带芯片将于 2023 年投产，采用的是台积电的 4nm 制程技术。

（资料来源：财联社）

半导体设备

【行业】2021 年全球半导体设备销售额首破 1000 亿美元，中国大陆成最大市场

近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布年终整体全球原始设备制造商（OEM）半导体设备预测报告，2021 年全球半导体制造设备总销售额将首次突破 1000 亿美元大关，达到 1030 亿美元，较此前的行业记录 710 亿美元（2020 年）飙升 44.7%，预计明年还将增长至 1140 亿美元。

（资料来源：腾讯网）

【行业】重庆力争“十四五”期间建成全国最大功率半导体生产基地

12月15日,为期2天的2021年中国半导体设备年会暨重庆半导体产业创新发展论坛在北碚区拉开序幕。市经济信息委相关负责人在会上透露,重庆正在谋划建设半导体设备重点集聚区,力争在“十四五”期间建成全国最大的功率半导体生产基地,让集成电路产业成为重庆制造业的一张新名片。

(资料来源:重庆日报)

【行业】半导体设备交期最长达30个月 晶圆联电拟175亿元提前抢购

《科创板日报》16日讯,晶圆代工厂联电董事会昨日通过资本预算执行案,预计投资762.73亿新台币(约合175亿人民币),采购南科晶圆厂2-3年后的设备,以供产能扩充。公司表示,目前制造设备交期最长达30个月,因此提前下手抢购。

(资料来源:财联社)

【行业】10余家上市公司上虞工厂因疫情临时停产 千亿市值半导体设备巨头在列

12月12日晚,国内半导体设备巨头晶盛机电(300316,SZ)公告称,绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组于12月9日下发了《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》,要求全区范围内“除防疫需要、民生保障外,其他企业一律停工”。根据上述通告,公司及下属公司位于上虞的厂区开始有序停产,全力配合政府防疫工作,遏制疫情扩散和蔓延。

(资料来源:每日经济新闻)

半导体材料

【行业】超400亿元,半导体业又一宗重大并购案

当地时间12月15日,美国半导体材料厂商Entegris宣布,将收购竞争对手CMC Materials,交易总价值为65亿美元(约合人民币413.88亿元)。该交易预计将于2022年下半年完成,但须满足惯例成交条件,包括监管部门和CMC Materials股东的批准。路透社引述花旗分析师报告中表示:“这项交易将增加Entegris的事业组合,使它们在半导体材料领域更接近一站式供应商。”

(资料来源:全球半导体观察)

【云南铝业】云南鑫耀半导体材料有限公司建设完成的产线具备砷化镓晶片产能为80万片/年

公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司前期建设完成的产线具备砷化镓晶片产能为80万片/年(2—4英寸),鉴于行业发展趋势及客户需求,公司正在进行生产工艺调整和改进,力图实现6英寸规格的砷化镓晶片的规模化生产能力。

(资料来源:每日经济新闻)

【行业】默克公司宣布在台湾投资38.96亿元加码半导体材料研发

半导体材料供应商德国默克(MERCK)公司14日宣布,将在5-7年内投资台湾约新台币170亿元(约合人民币38.96亿元),专注电子科技事业体新产线及研发实力的大幅扩张,并着重半导体事业发展。默克公司表示,这次投资案将是默克在台湾营运30多年以来规模最大投资,将创造400个全新工作,也使台湾默克半导体科技事业员工数成长超过一倍。

(资料来源:中电网)

晶圆代工&芯片制造

【SK 海力士】SK 海力士加码无锡，抢国内八英寸晶圆代工订单

据台媒 MoneyDJ 报道，SK 海力士（SK Hynix）冲刺晶圆代工事业，出手抢攻中国市场。旗下关系企业 SK Hynix System IC 即将关闭南韩 M8 厂，设备转运往中国无锡。SK Hynix System IC 无锡厂 2020 年第一季完工，2020 年下半年开始搬运 M8 厂设备至无锡，新厂已部分营运。SK Hynix System IC 预计明年上半年完成迁厂事宜，届时将全力抢攻中国 8 吋晶圆代工市场。无锡厂每月能生产 10 万片 8 吋晶圆。

（资料来源：半导体前沿）

【英特尔】消息称英特尔 CEO 拜访台积电敲定 3nm 晶圆代工订单

《科创板日报》15 日讯，据市场消息称，英特尔 CEO 基辛格昨日与台积电高层见面，获得 3nm 代工产能。业内认为，英特尔为巩固自身市占，在先进制程技术部分必须寻求外援，需委托台积电代工，预计从晶圆制造到封装，有望全部采用台积电解决方案。

（资料来源：科创板日报）

【赛维电子】瑞典子公司收购德国产线资产

北京赛微电子股份有限公司位于瑞典的全资子公司 Silex Microsystems AB 拟以 8,450 万欧元（其中包含 700 万欧元的在制品款项）收购德国 Elmos Semiconductor SE 的汽车芯片制造产线相关资产。

（资料来源：赛维电子公告）

【行业】提前锁定半导体产能，宝马宣布与芯片制造商直接结盟

12 月 8 日宝马汽车表示，公司与德国芯片制造商 IINOVA、美国芯片制造商格芯(Global Foundries)签订了一项长期芯片供应协议，以保证每年“几百万”枚芯片的供应。据悉，这两家公司供应的芯片将优先用在宝马新款旗舰纯电动车型 iX 上，部分芯片将用于研发、生产车载照明系统。也就是说，宝马集团将和其他厂商联合开发 ISELED 智能 LED 技术，该技术也将首次配备于宝马 iX 上。

（资料来源：LED 在线）

封测

【安世半导体】新增 250 亿颗，产能提升 85%！闻泰安世马来西亚封测厂大幅扩产

作为全球知名 IDM 厂商，安世半导体在分别于马来西亚、菲律宾、中国东莞建有封测厂，马来西亚封测厂现在主要生产小信号 MOS 和二极管器件。此次扩产计划起始于 2021 年 11 月，预计在 2022 年 5 月可实现基层库房和一楼行政的部分搬迁，并实现新产能。在此次扩产中，原料仓库和生产车间将实现全自动化配备。扩产后产能将新增 250 亿颗，产能提升 85%，并将在数字化和自动化方面实现迭代，在安世半导体的产品规划上承担更重要的角色。

（资料来源：中金在线）

【英特尔】将投资逾 70 亿美元在马来西亚新建一个芯片封装和测试工厂

12 月 16 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，芯片制造商英特尔首席执行官（CEO）帕特·盖尔辛格（Pat Gelsinger）表示，将投资逾 70 亿美元在马来西亚新建一个芯片封装和测试工厂，该工厂预计将于 2024 年开始投产。

（资料来源：新浪）

功率器件

【森国科】碳化硅功率器件公司森国科完成亿元级C轮融资，中金资本领投

12月14日，国内领先的碳化硅功率器件厂商深圳市森国科科技股份有限公司（下称“森国科”）宣布完成C轮亿元融资。本轮投资领投方为中金资本，国家科学技术部下属国家科技风险开发事业中心投资的中科海创基金、广东凌霄泵业有限公司（002884.SZ）跟投。

本轮融资将继续用于产研投入、业务拓展和服务体系的升级，推动产品研发及迭代。IT桔子数据显示，森国科过往股东还包括A轮和B轮的投资方北汽产投、蓝思科技（300433.SZ）、第一创业证券（002797.SZ）、湖南国微创投基金、粤科鑫泰股权基金等投资机构。

（资料来源：搜狐）

【比亚迪】比亚迪半导体新款功率器件驱动芯片自主研发告成！12月实现批量供货

近期，比亚迪半导体基于先前研发成果的稳固基础上，继续整合自身优势，成功自主研发并量产1200V功率器件驱动芯片——BF1181，今年12月实现向各大厂商批量供货。BF1181是一款磁隔离单通道栅极驱动芯片，用于驱动1200V功率器件，同时具有优异的动态性能和工作稳定性，并集成了多种功能，如故障报警，有源密勒钳位，主次级欠压保护等。BF1181还集成了模拟电平检测功能，可用于实现温度或电压的检测，并提高芯片的通用性，进一步简化系统设计，如尺寸与成本等。

（资料来源：红星新闻）

【行业】新型功率半导体器件开发商芯长征宣布完成超5亿元C轮融资

近日，新型功率半导体器件开发商芯长征宣布完成超5亿元C轮融资，本轮融资由鼎晖投资领投，北汽产业投资、高榕资本、芯动能投资、国科嘉和、一汽力合、华登国际、贵阳创投、华胥基金、新潮集团、江宁经开基金、华金资本、云晖资本、南曦资本等跟投。指数资本担任独家财务顾问。据悉，该笔资金将主要用于进一步加强新能源汽车和光伏类产品研发投入，并持续扩大产能。

（资料来源：半导体芯情）

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓：新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

半导体材料国内市场增速放缓：半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去 5 年中 CAGR 达到了 10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备：由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近 50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话：
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371